

中国光芯片外延片行业发展分析及发展预测研究报告(2026-2031版)

报告简介

外延是半导体工艺当中的一种。在bipolar工艺中，硅片最底层是P型衬底硅(有的加埋层);然后在衬底上生长一层单晶硅，这层单晶硅称为外延层;再后来在外延层上注入基区、发射区等等。最后基本形成纵向NPN管结构：外延层在其中是集电区，外延上面有基区和发射区。外延片就是在衬底上做好外延层的硅片。因有些厂只做外延之后的工艺生产，所以他们买别人做好外延工艺的外延片来接着做后续工艺。

根据国内第三方工商注册服务机构--

"企查查"查询结果显示，截止2021年12月底，国内"存续"和"在业"的企业中业务包含"光芯片或者外延片"，并通过查找范围"品牌/产品"，筛选之后企业有19996家，同比2020年年底的11698家增长8298家。

从光芯片外延片行业人员规模企业发布的人才需求来看，研发和销售是企业人员需求量最大的两个部分，对研发岗位的需求高达55%，其后是销售客户支持类岗位，占18%。

2019年中国光芯片外延片市场规模为112亿元，2020年受新冠疫情影响，中国光芯片外延片市场规模有所下降，但随着相关领域投资建设规模的扩大，中国光芯片外延片市场需求将持续增长，2021年光芯片外延片行业市场规模达到125亿元，同比增长17.92%。在旺盛需求的推动下，国内严格的疫情防控措施为国内外光芯片外延片工厂提供复工生产、调升稼动率弥补库存的可能，因此产能扩张带来的刚需以及提前抢单共同推动了中国大陆地区光芯片外延片工业产值的增长，2021年光芯片外延片行业工业总产值达到118亿元，同比增长16.83%。中国光芯片外延片产业结构逐步由小而全的综合制造模式逐步走向设计、制造、封装测试三业并举，各自相对独立发展的格局。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及光芯片外延片畜牧领域行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国光芯片外延片畜牧领域行业

的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外光芯片外延片畜牧领域行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了光芯片外延片畜牧领域行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于光芯片外延片畜牧领域产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国光芯片外延片畜牧领域行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

报告目录

第一章 光芯片外延片行业发展综述

第一节 光芯片外延片行业定义及特征

一、光芯片外延片的界定

二、光芯片外延片优势

1.提高光芯片外延片材料的质量

2.稳定光器件性能

3.促进新材料、新器件的开发

第二节 光芯片外延片的分类

一、正外延和反外延

二、同质外延和异质外延

三、气相外延、液相外延和固相外延

四、直接外延和间接外延

第三节 光芯片外延片行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒/退出机制

五、风险性

六、行业周期

第二章 光芯片外延片行业发展环境分析

第一节 行业经济环境分析

一、gdp增长状况分析

二、固定资产投资状况分析

三、工业增加值状况分析

第二节 行业政策环境分析

一、行业相关政策动向

二、相关产业政策

三、光芯片外延片制造行业发展规划

四、进出口政策影响分析

第三节 行业技术环境分析

一、光芯片外延片技术原理

二、光芯片外延片技术发展历程

三、国内光芯片外延片技术成熟度

四、技术对光芯片外延片的影响

五、光芯片外延片技术发展趋势

第三章 国际光芯片外延片行业发展经验借鉴

第一节 美国光芯片外延片行业发展经验借鉴

一、美国光芯片外延片行业发展历程分析

二、美国光芯片外延片行业运营模式分析

三、美国光芯片外延片行业发展趋势预测分析

四、美国光芯片外延片行业对中国的启示

第二节 日本光芯片外延片行业发展经验借鉴

一、日本光芯片外延片行业发展历程分析

二、日本光芯片外延片行业运营模式分析

三、日本光芯片外延片行业发展趋势预测分析

四、日本光芯片外延片行业对中国的启示

第三节 德国光芯片外延片行业发展经验借鉴

一、德国光芯片外延片行业发展历程分析

二、德国光芯片外延片行业运营模式分析

三、德国光芯片外延片行业发展趋势预测分析

四、德国光芯片外延片行业对中国的启示

第四章 中国光芯片外延片所属行业整体运行指标分析

第一节 中国光芯片外延片所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 中国光芯片外延片所属行业产销情况分析

一、中国光芯片外延片工业总产值

二、中国光芯片外延片销售产值

三、中国光芯片外延片产销率

第三节 中国光芯片外延片所属行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第四节 2021-2026年光芯片外延片价格走势分析

一、25gdfb激光器外延片价格走势

二、25gingaas高速探测器外延片价格走势

三、ingaasapd雪崩探测器外延片价格走势

四、太赫兹波段utc探测器外延片价格走势

第五章 中国光芯片外延片行业运行现状分析

第一节 国际光芯片外延片行业发展分析

一、国际光芯片外延片行业发展概况

二、国际光芯片外延片市场竞争分析

第二节 中国光芯片外延片行业发展概况

一、光芯片外延片行业总体发展概况

二、光芯片外延片国产化进展状况分析

三、光芯片外延片行业发展影响因素

四、光芯片外延片项目最新审批动向

第三节 中国光芯片外延片市场情况分析

一、中国光芯片外延片市场总体概况

二、中国光芯片外延片产品市场发展分析

第四节 中国光芯片外延片市场价格走势分析

一、光芯片外延片市场定价机制分析

二、光芯片外延片市场价格影响因素

三、光芯片外延片产品价格走势分析

四、光芯片外延片产品价格走势预测分析

第六章 光芯片外延片需求分析

第一节 2021-2026年国内光芯片外延片需求分析

一、2021-2026年国内光芯片外延片需求规模

二、2021-2026年国内光芯片外延片需求结构

三、2021-2026年国内光芯片外延片需求区域分布

第二节 光芯片外延片需求趋势及需求潜力预测

一、2026-2031年国内光芯片外延片需求趋势

二、2026-2031年国内光芯片外延片需求潜力

第七章 中国光芯片外延片所属行业进出口情况分析

第一节 光芯片外延片所属行业进出口综述

一、中国光芯片外延片进出口的特点分析

二、中国光芯片外延片进出口地区分布情况分析

三、中国光芯片外延片进出口的贸易方式及经营企业分析

四、中国光芯片外延片进出口政策与国际化经营

第二节 光芯片外延片进出口市场分析

第三节 中国光芯片外延片进出口面临的挑战及对策

- 一、中国光芯片外延片所属行业进出口前景
- 二、中国光芯片外延片进出口面临的挑战
- 三、中国光芯片外延片进出口发展对策与建议

第八章 光芯片外延片所属行业区域市场分析

第一节 华北地区光芯片外延片行业分析

- 一、行业发展现状分析
- 二、市场规模情况分析
- 三、市场需求情况分析
- 四、行业发展前景预测

第二节 东北地区光芯片外延片行业分析

- 一、行业发展现状分析
- 二、市场规模情况分析
- 三、市场需求情况分析
- 四、行业发展前景预测

第三节 华东地区光芯片外延片行业分析

- 一、行业发展现状分析
- 二、市场规模情况分析
- 三、市场需求情况分析
- 四、行业发展前景预测

第四节 华南地区光芯片外延片行业分析

- 一、行业发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第五节 华中地区光芯片外延片行业分析

一、行业发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第六节 西南地区光芯片外延片行业分析

一、行业发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第七节 西北地区光芯片外延片行业分析

一、行业发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第九章 光芯片外延片行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、光芯片外延片行业竞争结构分析

二、光芯片外延片行业企业间竞争格局分析

三、光芯片外延片行业集中度分析

四、光芯片外延片行业swot分析

第二节 中国光芯片外延片行业竞争格局综述

一、光芯片外延片行业竞争概况

二、中国光芯片外延片行业竞争力分析

三、中国光芯片外延片产品竞争力优势分析

四、光芯片外延片行业主要企业竞争力分析

第三节 光芯片外延片行业并购重组分析

一、本土企业投资兼并与重组分析

二、行业投资兼并与重组趋势预测

第十章 中国光芯片外延片行业主要经营分析

第一节 江苏华兴激光科技有限公司

一、公司基本概况

二、公司光芯片外延片产品分析

三、公司光芯片外延片产销量及典型客户

四、公司光芯片外延片销售渠道分析

五、公司发展动态及未来规划

第二节 全磊光电股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司光芯片外延片产品分析【产品性能、价格、应用领域等】

三、公司光芯片外延片产销量及典型客户

四、公司光芯片外延片销售渠道分析

五、公司发展动态及未来规划

第三节 陕西源杰光芯片外延片科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司光芯片外延片产品分析【产品性能、价格、应用领域等】

三、公司光芯片外延片产销量及典型客户

四、公司光芯片外延片销售渠道分析

五、公司发展动态及未来规划

第四节 福建中科光芯光电科技有限公司

一、公司基本概况

二、公司光芯片外延片产品分析【产品性能、价格、应用领域等】

三、公司光芯片外延片产销量及典型客户

四、公司光芯片外延片销售渠道分析

五、公司发展动态及未来规划

第十一章 2026-2031年光芯片外延片行业前景及趋势预测分析

第一节 2026-2031年光芯片外延片市场发展前景

一、2026-2031年光芯片外延片市场发展潜力

二、2026-2031年光芯片外延片市场发展前景展望

第二节 2026-2031年中国光芯片外延片行业供需预测分析

一、2026-2031年中国光芯片外延片行业供给预测分析

二、2026-2031年中国光芯片外延片行业产值预测分析

三、2026-2031年中国光芯片外延片市场销售产值预测分析

四、2026-2031年中国光芯片外延片行业供需平衡预测分析

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势预测分析

- 一、市场整合成长趋势预测分析
- 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测分析
- 三、企业区域市场拓展的趋势预测分析
- 四、科研开发趋势及替代技术进展
- 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势预测分析

第十二章 2026-2031年光芯片外延片行业投资机会与风险防范

第一节 光芯片外延片行业投融资状况分析

- 一、行业资金渠道分析
- 二、固定资产投资分析
- 三、兼并重组情况分析
- 四、光芯片外延片行业投资现状分析

第二节 光芯片外延片行业投资机会分析

- 一、产业链投资机会
- 二、细分市场投资机会
- 三、重点区域投资机会
- 四、光芯片外延片行业投资机遇

第三节 光芯片外延片行业投资风险及防范

- 一、研发风险
- 二、技术人才短缺或流失的风险
- 三、技术泄密风险
- 四、供应链的风险

五、宏观经济波动和行业周期性的风险

第四节 中国光芯片外延片行业投资建议

一、光芯片外延片行业未来发展方向

二、光芯片外延片行业主要投资建议

三、中国光芯片外延片企业融资分析

附录

第一节 《国家集成电路产业发展推进纲要》

一、国家集成电路产业发展推进纲要

二、工信部介绍《国家集成电路产业发展推进纲要》情况

三、《国家集成电路产业发展推进纲要》提出,加强集成电路知识产权的运用和保护

四、《国家集成电路产业发展推进纲要》纲要内容

五、《国家集成电路产业发展推进纲要》纲要解读

六、关于《推进纲要》的主要内容

七、关于《推进纲要》措施的几个亮点

第二节 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

图表目录

图表：行业发展周期

图表：行业相关政策

图表：2021-2026年光芯片外延片行业企业数量分析

图表：2021-2026年光芯片外延片行业人员规模状况分析

图表：2021-2026年光芯片外延片行业资产规模分析

图表：2021-2026年光芯片外延片行业市场规模分析

图表：2021-2026年中国光芯片外延片工业总产值

图表：2021-2026年中国光芯片外延片销售产值

图表：2021-2026年中国光芯片外延片产销率

图表：2021-2026年中国光芯片外延片行业盈利能力

图表：2021-2026年中国光芯片外延片行业偿债能力

图表：2021-2026年中国光芯片外延片行业营运能力

图表：2021-2026年中国光芯片外延片行业发展能力

图表：2021-2026年25gdff激光器外延片价格走势

图表：2021-2026年25gingaas高速探测器外延片价格走势

图表：2021-2026年ingaasapd雪崩探测器外延片价格走势

图表：2021-2026年太赫兹波段utc探测器外延片价格走势

图表：2021-2026年国内光芯片外延片需求规模

图表：2021-2026年中国光芯片外延片进出口地区分布情况分析

图表：中国光芯片外延片进出口的贸易方式及经营企业分析

图表：2021-2026年中国光芯片外延片进出口的特点分析

图表：华北地区市场规模情况

图表：东北地区市场规模情况

图表：华东地区市场规模情况

图表：华南地区市场规模情况

图表：华中地区市场规模情况

图表：西南地区市场规模情况

图表：西北地区市场规模情况

图表：福建中科光芯光电科技有限公司外延片产品特点

图表：2026-2031年中国光芯片外延片行业供给预测分析

图表：2026-2031年中国光芯片外延片行业产值预测分析

图表：2026-2031年中国光芯片外延片市场销售产值预测分析

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：245136

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20220129/245136.shtml>

在线订购：[点击这里](#)